

证券代码：600641

证券简称：万业企业

## 上海万业企业股份有限公司

### 2024 年第三季度业绩说明会会议纪要

投资者关系活动类别	业绩说明会
参与对象	投资者
时间	2024 年 11 月 28 日 11:00-12:00
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	万业企业董事、总裁李勇军先生 万业企业董事刘荣明先生 万业企业独立董事王国平先生 万业企业独立董事夏雪女士 万业企业独立董事万华林先生 万业企业副总裁、董事会秘书周伟芳女士 万业企业副总裁江加如先生 万业企业首席财务官邵伟宏先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：公司情况介绍：</p> <p>上海万业企业股份有限公司成立于 1991 年，并于 1993 年在上交所主板上市。作为一家具有新兴产业基因的高科技上市公司，近年来，公司在控股股东浦科投资的带领下，秉持卓越的创新实力和坚定的自主研发精神，通过“外延并购+产业整合”双轮驱动战略布局半导体设备材料赛道，持续加大集成电路在公司整体业务中的比重，致力于支持国产设备的发展成长。</p> <p>公司专注于自主研发核心设备，致力于开发全系列离子注入机产品。旗下凯世通是国内领先的高端集成电路离子注入机装备企业，处于国内 12 英寸低能大束流离子注入机的领先地位，持续领跑国产低能大束流和高能离子注入机系列产品的产业化进程。不仅在产品交付量和工艺覆盖率方面均处于国内前沿，还多次承担国家及上海市科技专</p>

项，先后荣获上海市科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉。万业企业不断深化全系列产品矩阵布局，作为国内首家获得 CIS 低能大束流离子注入机订单的本土设备供应商，更积极推动 SOI 氢离子注入机、中束流离子注入机、超高能离子注入机等特色工艺设备的研发和应用，持续拓宽不同细分领域的产业边界。

未来，万业企业还将持续并进横向拓展与纵向深耕，开拓上下游产业链整合、深化半导体核心设备领域的战略布局，提升关键装备的自主可控水平，不断为推动中国集成电路产业的蝶变跃升赋能。

#### 第二部分：主要交流问答：

Q：请董秘介绍一下今年公司前三季度的经营情况？

A：尊敬的投资者，您好。2024 年受半导体行业下游复苏回暖影响，公司紧握行业发展机遇，持续投入研发，业绩出现转好态势。2024 年前三季度，公司实现营收 3.08 亿元，其中第三季度实现归母净利润 3,913.33 万元，实现扣非净利润 1,263.30 万元，净利润数据均实现环比扭亏为盈，业绩转好趋势显现。在研发方面，公司持续加大投入，2024 年前三季度研发投入达到 1.22 亿元，较去年前三季度同比增长 3.39%。凭借持续的研发投入，公司不断增强集成电路领域产品的发展动能。其中公司旗下凯世通自 2020 年突破首台设备订单后，已赢得十余家国内主流晶圆厂客户离子注入机的采购订单，近 60 台订单数中超过 50%为重复订单。此外，凯世通专注于研发多款面向细分领域的离子注入机，形成全系列产品矩阵布局，在全球经济逐步复苏和半导体需求增长的推动下，未来或将迎来更大的市场机遇。感谢您的关注！

Q：从财务报表看公司营收数据出现下滑的主要原因是什么？

A：尊敬的投资者，您好。自 2024 年起，随着公司房地产板块进入收尾阶段，存量出清带来营收与利润的短期影响。今年前三季度，

公司营业收入同比减少的原因主要是房地产业务板块进入收尾阶段，交房收入较上年同期减少所致。感谢您的关注！

Q: 从今年的研发看，公司依旧保持着高额的研发投入，请问后续还会保持这种趋势吗？

A: 尊敬的投资者，您好。为了实现公司产品核心竞争力的进一步提升，公司在原有深厚的技术储备基础上，持续聚焦客户产业化需求和最新技术趋势，保持高水平的研发投入，不断进行产品开发和优化。2024年前三季度公司研发投入为1.22亿元，相较去年同期增长3.39%。大量研发投入带来的技术成果为公司后续发展提供了坚实后盾，成为市场竞争力进一步提升的重要保障。同时凭借大量的研发投入，公司在国内多家关键芯片制造产线中率先完成了技术验证及产业化应用。今年，公司通过上下游产业链协同创新，持续积累经验曲线，收获重复采购订单，并不断拓展新的产业客户。未来，公司将持续引进行业内精英人才，不断提升研发水平，为客户提供性能卓越、稳定可靠、降本增效的先进设备和工艺解决方案。感谢您的关注！

Q: 下半年凯世通获得了上海科学技术奖一等奖，请问具体获奖项目是什么，含金量如何？

A: 尊敬的投资者，您好。今年下半年，万业企业旗下上海凯世通半导体股份有限公司联合重点应用企业共同完成的“离子注入机技术与应用产业化”项目荣获上海市科技进步奖一等奖。上海市科学技术奖由上海市人民政府统一设立，是上海市深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，服务高水平科技自立自强，加大对科学规律的第一发现者、技术发明的第一创造者、创新产业的第一开拓者、创新理念的第一实践者的奖励。针对离子注入实际生产过程中亟需突破的关键工程技术问题，凯世通创新构建了包括基础研究和应用技术在内的“通用平台+关键技术模块+系统集成+应用技术”完整技术体系，形成了一系列高价值的自主知识产权成果。凯世通秉持自主

创新的研发理念，致力于实现离子注入机关键技术自主可控。此次获奖项目所研发的低能大束流离子注入机系列设备是制造逻辑芯片、DRAM 存储芯片、功率器件、CIS 芯片的核心设备，设备性能与稳定性表现卓越，实现了集成电路重大装备产业化突破。目前，凯世通已打造出多款离子注入机标杆项目，在国内主流 12 英寸晶圆厂实现了产业化并收获了批量重复订单。随着产业化进程加快，凯世通将持续提升产能，增强服务客户能力，为国内半导体行业发展增添动力。感谢您的关注！

Q: 今年截至目前凯世通的订单情况如何？

A: 尊敬的投资者，您好。随着我国集成电路的发展不断前进，万业企业旗下凯世通以卓越的创新实力和坚定的自主研发精神，成功研发并量产了国内领先的系列集成电路离子注入机产品，2020 年至今获得国内主流晶圆厂客户 12 英寸离子注入机批量采购订单近 60 台，彰显了公司国产高端装备的优质竞争力。近四年来，凯世通累计签署 12 英寸集成电路离子注入机设备订单总数近 60 台，订单总金额近 14 亿元，并且已完成交付 30 台，涵盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS 图像传感器四大应用领域。今年凯世通自主研发生产的 CIS（CMOS 图像传感器）低能大束流离子注入机正式入驻客户生产线，凯世通也成为中国首个获得此类订单的本土供应商，并且已经赢得了该客户的追加采购意向。自去年以来，凯世通加大了对细分领域专用离子注入机的开发力度，形成了涵盖 SOI 氢离子注入机、6/8 英寸 SiC 高温离子注入机、中束流离子注入机及超高能离子注入机等在内的全系列产品矩阵布局，致力提升重大装备自主可控能力，同时也为未来实现更加多元化的客户结构奠定了坚实基础。感谢您的关注！

Q: 请问凯世通的大束流离子注入机产品在市场的核心竞争力主要体现在哪些方面？

A: 尊敬的投资者，您好。万业企业控股子公司凯世通所涉核心装

备业务是以离子注入技术为核心的集研发、制造、销售于一体的高端离子注入机项目，重点应用于集成电路领域，目前营业收入包括自研离子注入机、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务等。凯世通是国内集成电路离子注入机高端装备领先企业，其低能大束流离子注入机系列产品已批量应用于国内主流的 12 英寸晶圆厂生产线，是国内领先的 12 英寸低能大束流离子注入机供应商，在产品交付量和工艺覆盖率方面均处于行业前沿，凯世通高能离子注入机率先完成产线验证与验收。同时低能大束流离子注入机是凯世通自主研发的主力设备，经过了多家主流 12 英寸晶圆厂的产品验证与迭代升级，具备优异的电性参数、注入角度与均匀性，曾荣获上海市科技进步一等奖、北京市科技进步一等奖、上海市高新技术成果转化项目自主创新十强等荣誉。今年凯世通还成为国内首家获得 CIS 低能大束流离子注入机订单并完成交付的国产设备供应商，并且已经赢得了该客户的追加采购意向，彰显行业核心竞争力。感谢您的关注！

Q: 公司转型半导体后主要产品就是离子注入机，请问现在公司离子注入机产品的核心竞争优势是什么？

A: 尊敬的投资者，您好。凯世通紧跟技术发展趋势和客户需求，不断强化离子注入机领域的技术领先优势。针对 28nm 及更先进工艺对离子注入高精度、极少颗粒污染、高良率大产能的需求，采用多电极束流引出技术、超低能束流传输技术、离子束能量过滤技术、各向同性扫描、离子注入平台等技术，研制了注入角度控制更加精准的真空各向同性机械扫描系统、超细微颗粒污染控制、覆盖工艺广的离子注入机系列产品，推进全系列离子注入机的产业化。通过多项技术的突破，凯世通不断增强产品核心竞争力建立行业壁垒，并收获客户的广泛认可。感谢您的关注！

Q: 请问领导，今年凯世通已经突破了 CIS 离子注入机产品的交付，后续凯世通离子注入机产品还有望攻破哪些领域呢？

A: 尊敬的投资者，您好。今年3月，凯世通自主研发生产的新品 CIS 低能大束流离子注入机已搬入客户产线完成交付，成为国内首家获得 CIS 低能大束流离子注入机订单的国产设备供应商。目前凯世通正在积极对标国内集成电路产业发展新需求新应用，瞄准前沿集成电路工艺演进趋势，把握国产化机遇，推进包括 SOI 氢离子注入机、中束流离子注入机、超高能离子注入机等特色工艺设备落地，并加快面向特色工艺的 SiC 化合物半导体离子注入机的研发与应用。感谢您的关注！

Q: 碳化硅作为当今半导体行业的主要材料，发展前景非常广阔，公司是怎么看待的？

A: 尊敬的投资者，您好。作为第三代半导体材料的典型代表，碳化硅（SiC）拥有优异的物理和化学特性，可满足中低压、高压、超高压功率器件制备要求。SiC 器件可广泛应用于电动汽车、轨道交通、智能电网、通信雷达和航空航天等领域。通过市场对高性能、高可靠性的半导体器件需求急剧增加，进一步推动了离子注入机市场的增长。碳化硅等第三代半导体材料的掺杂需要极高的精度和均匀性，针对不同半导体材料和器件结构的需求，离子注入机需具备多能量和多种离子注入的能力。例如 SiC 功率器件掺杂工艺中，需要极高温才能得到理想的扩散系数，并可以最大限度地减少离子轰击对晶格的破坏，因此高温离子注入机成为碳化硅功率器件制造中关键核心的设备。凯世通在该领域持续进行研发创新，基于已有的技术积累，研发面向碳化硅的高温离子注入机。感谢您的关注！

Q: 领导您觉得随着芯片行业不断的更新换代，离子注入机未来的发展方向是什么？

A: 尊敬的投资者，您好。随着芯片制造工艺不断走向精密化，市场对于集成电路设备的性能提出了更高的技术要求。对离子注入而言，芯片设计的日益复杂，对离子注入机提出更高的技术要求，如高能量、

高精度、高均匀度、低污染等，所需的离子注入工序亦相应增加。同时，芯片制程的升级也带来了新的掺杂需求，如 SOI、MEMS 等特殊工艺，这就需要开发新型的离子注入机来满足。目前凯世通正在积极对标国内集成电路产业发展新需求新应用，瞄准前沿集成电路工艺演进趋势，把握国产化机遇，推进包括 SOI 氢离子注入机、中束流离子注入机、超高能离子注入机等特色工艺设备落地，并加快面向特色工艺的 SiC 化合物半导体离子注入机的研发与应用。感谢您的关注！

Q: 公司既然要从房地产转型半导体，研发肯定非常重要，今年公司的研发团队有什么变化吗？

A: 尊敬的投资者，您好。万业企业在强化半导体产业链条的同时，也在积极投入加大对半导体专业人才链的投资。今年上半年，公司结合业务发展需要，持续加强人才梯队建设，公司研发人员人数从 157 人增长到 179 人，研发人员人数增长率为 14%。人才引进方面，公司拓宽人才吸引渠道，从国内外吸引了行业经验丰富的管理及专家级技术人才团队，并吸引优秀应届生的加入，为公司战略发展注入新动能。人才培养方面，公司持续优化培训体系，组织开展多项深入的专题培训和学习交流，探索校企合作新模式，推荐优秀工程师进行在职教育，为员工的多方面发展提供平台与机会。此外，在人才激励方面，公司重视员工薪酬激励制度体系的建设，并通过实施员工持股计划，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公司与员工的共赢。如今，凯世通已建立了一支由顶尖离子注入设备专家引领的有梯队、有层次、多元化的技术创新团队，多次承担国家及上海市科技专项，先后荣获上海市科技进步一等奖、上海市科技进步二等奖、北京市科技进步一等奖、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉。感谢您的关注。

Q: 请问董秘，公司目前有多少发明专利？

A: 尊敬的投资者，您好。公司高度重视科技创新和知识产权保护

工作。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 321 项，其中发明专利 178 项，实用新型专利 135 项，其他 8 项；已授权专利 209 项，其中发明专利 96 项，实用新型专利 105 项，外观设计专利 8 项。感谢您的关注！

Q: 除了离子注入机外，凯世通还有哪些业务服务？

A: 尊敬的投资者，您好。除离子注入机整机设备产品外，凯世通还从事相关的耗材和非耗材等备件的销售与技术服务，由于离子注入机属于运动损耗、材料消耗较多的工艺设备，在设备运行一定周期后需要进行维保或更换配件才能保证设备性能。随着公司设备保有量的持续增加，离子注入机耗材与维修保养等技术服务需求相应提升有望成为公司新的业务增长点。感谢您的关注！

Q: 在房地产业务方面，公司今年是怎么打算的？

A: 尊敬的投资者，您好。公司房地产业务目前主要是存量房产的销售和经营，已无新的房产开发项目。公司房地产业务已进入收尾阶段，后续在加速房地产去化库存同时，公司将做好集成电路转型产业的基地建设和运营工作，通过强化转型协同和叠加效应助力集成电路核心装备业务良好发展。感谢您的关注！

Q: 请问三季度公司房地产部分销售进度如何？

A: 尊敬的投资者，您好。2024 年第三季度，公司房地产开发无新增土地储备，房地产项目销售累计签约面积为 13,025 平方米，同比增加 5740.81%；签约金额为 8,738 万元，同比增加 1250.54%，感谢您的关注！

Q: 请问房地产业务的逐步出清是否会加速公司向集成电路领域转型？

A: 尊敬的投资者，您好。目前，公司存量房产的销售所产生的收

入和现金流能为集成电路领域业务提供有力保障。随着房地产项目的资金回笼，公司现金较为充裕，能够加速向半导体行业转型并为公司的集成电路业务发展提供资金基础和运营优势。感谢您的关注！

Q: 请问公司对今年半导体行业的发展是怎么看待的？

A: 尊敬的投资者，您好。作为新质生产力的典型代表，集成电路设备市场空间广阔。当前，人工智能、云计算、物联网、智能驾驶等新兴产业蓬勃发展，对半导体产业需求日益旺盛，为全球半导体设备市场注入了强劲动力。根据美国半导体行业协会（SIA）近日发布的数据显示，2024年第三季度，全球半导体销售额达到1660亿美元，同比增长23.2%；环比增幅10.7%，达到2016年以来的最高水平。同时根据WSTS的预测，上调预测2024年全球半导体市场销售额同比增长16%，预计2025年将同比增长12.5%。从国内市场看，近年来国家大力支持科技产业，我国半导体产业链国产化迎来机遇。2018年以来，PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备、CMP等核心前道设备国产化率进一步突破，从个位数增长到10%以上。材料国产化也提速明显，抛光垫、抛光液、硅片、溅射靶材等核心材料也实现了稳步提升。2024年9月，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，提出要支持上市公司向新质生产力转型升级，国家大力支持科技产业，助力半导体产业实现自主可控。当前国内半导体设备供应商正迎来广阔发展空间，公司将主动把握半导体产业链创新发展的机遇，加快已有产品市场渗透与新产品的研发量产。感谢您的关注！

Q: 今年下半年以来市场上并购重组的案例越来越多，公司后续是否会在并购重组上面有突破？

A: 尊敬的投资者，您好。万业企业通过“外延并购+产业整合”的方式，积极寻找集成电路上下游并购项目，不局限于协同并购、联合投资以及促进资源整合等多种策略来积极布局集成电路产业，从而增强公司核心竞争力，感谢您的关注！

Q: 请问公司如何看待半导体行业后续的发展趋势?

A: 尊敬的投资者,您好。随着全球经济加速复苏和新兴产业的快速发展,半导体市场迈入新阶段。特别是在新能源汽车、人工智能等领域蓬勃发展势头下,半导体产品的需求量不断攀升,这为半导体设备企业提供了广阔的市场空间和发展机遇。SEMI 发布《300mm 晶圆厂 2027 年展望报告》指出,从 2025 年到 2027 年,全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将达到创纪录的 4000 亿美元。强劲的支出是由半导体晶圆厂的区域化以及数据中心和边缘设备对人工智能(AI)芯片日益增长的需求推动的。

2024 年,全球 300mm 晶圆厂设备支出预计将增长 4%,达到 993 亿美元,到 2025 年将进一步增长 24%,首次突破 1000 亿美元,达到 1232 亿美元。预计 2026 年支出将增长 11%,达到 1362 亿美元,2027 年将增长 3%,达到 1408 亿美元。预计到 2027 年,中国将保持其作为全球 300mm 设备支出第一的地位,未来三年将投资超过 1000 亿美元。近年来,在复杂多变的国际形势及我国持续加大半导体产业政策扶持的背景下,中国大陆半导体产业发展迅速,在半导体技术迭代创新、产业生态等方面均形成良好效果,但高端半导体设备自给率仍较低,这也为国内半导体设备厂商的发展提供了巨大的成长机遇。基于当前国际、国内市场现状以及技术发展趋势,半导体设备核心技术独立性和自主可控紧迫性愈加凸显,实现集成电路产业高质量发展,需要半导体设备厂商不断加强技术创新,推动设备向高精度化与高集成化方向发展,并逐步完善半导体产业链,最终实现上下游行业协同发展,共享共赢。面对这些发展机遇和挑战,公司将进一步巩固和提升核心竞争优势,继续优化经营管理,持续开拓市场,为长远发展做好规划和积淀,努力为股东创造价值。感谢您的关注!

Q: 公司现在的离子注入机产品在市场客户端认可的还是很不错的,请问公司认为半导体设备从研发到生产主要的流程是什么,有哪

些细节？

A：尊敬的投资者，您好。公司旗下凯世通专注于离子注入机技术的研发与产业化，秉承技术引领和创新突破的理念，凭借前沿技术和卓越服务，成为国内高端离子注入机领域的领军者，产品饱受客户好评。在产品研发生产过程中，公司认为集成电路设备产品研发及量产的流程主要包括7个阶段。规划和概念阶段：公司根据客户需求与行业前沿技术，对产品开发进行研究规划；设计阶段：研发立项后，公司机械、电气、软件、控制、工艺等研发科室对产品进行设计；开发实现阶段（Alpha、Beta）：设计完成后，公司将逐步开发 Alpha 与 Beta 机型产品；厂内测试阶段：公司对研制机台在厂内进行整机测试；产线验证阶段：整机测试通过的机台交付客户产线进行客户端验证；量产阶段：验证通过后的产品在客户端进行产业化生产；持续改进阶段：公司在客户的配合下对产品进行持续升级，不断完善产品性能，实现产品迭代。感谢您的关注！

Q：公司后续在半导体行业的发展方向是什么？

A：尊敬的投资者，您好。今年以来，半导体行业景气度逐渐回升，各类细分市场回暖情况不一。半导体设备作为产业链上游中高占比、高投入、高技术壁垒的重要基石之一，迎来复苏迹象。随着人工智能技术的迅猛发展，算力和高性能存储芯片成为产业链的关键节点，推动了集成电路装备的需求增长。在行业逐渐回暖、产业应用需求市场机遇的推动下，万业企业有望借助其核心装备布局实现稳健增长。展望未来，万业企业将专注于集成电路行业的发展，持续加大主业投入，强化新产品与优质项目的开发及储备，致力于成为集成电路高端装备行业的领军企业，力争实现营收、利润新突破。感谢您的关注。

Q：下半年公司出售富乐德的股票投资收益会对今年整体的业绩有什么影响吗？

A：尊敬的投资者，您好。10月25日，万业企业通过集中竞价交

易方式，出售所持安徽富乐德科技发展股份有限公司 A 股股票共计 3,298,700 股，占其总股本的 0.97%，成交均价为 59.57 元/股，成交金额为人民币 196,518,048.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司本次出售股票资产的事项有利于优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率。本次出售事项累计成交金额为人民币 196,518,048.41 元。公司将根据《企业会计准则》等有关规定对本次出售股票资产的收益进行会计处理，实际影响以注册会计师最终审计后的数据为准，感谢您的关注！

Q: 半导体行业对研发团队的要求极高，公司研发人员培养方面有哪些优势？

A: 尊敬的投资者，您好。万业企业采取双轮驱动的人才战略，既注重内部人才培养，又积极引进国内外在半导体设备技术和运营管理领域的资深专家，打造了由高端人才领衔的技术研发团队。公司以合作共赢为核心价值观，通过持续完善的长效激励机制，保障既有人才团队稳定的同时，不断增强对外部人才的吸引力，为全面构建具有创造力和竞争力的技术研发人才梯队持续增添力量。截至 2024 年上半年，公司旗下凯世通的研发技术人员总数达到 168 名，占其员工总数的 62.68%。凯世通作为公司的重要业务板块，其核心技术团队成员拥有 20-30 年在半导体设备开发领域的丰富经验，具备离子注入设备全系统的工程实现能力与实践经验。公司的研发与管理团队汇集了一批来自国内外著名高等学府的博士和硕士研究生，专业领域覆盖等离子体物理、半导体技术、机械工程、自动控制、软件工程等诸多学科。该团队在离子注入和半导体工艺领域拥有深厚的专业知识和丰富的产线量产经验，同时研发团队与生产和售后等职能部门深度融合，确保了产品端与市场端无缝衔接，进一步增强了公司产品和服务的创新改进及市场竞争力。感谢您的关注！